

ICS 77.150.99
H 68

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1105—2016

半导体封装用键合银丝

Silver bonding wire for semiconductor package

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国有色金属
行业标准
半导体封装用键合银丝

YS/T 1105—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年7月第一版

*

书号: 155066·2-31780

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位:烟台一诺电子材料有限公司、北京达博有色金属焊料有限责任公司、有色金属技术经济研究院、山东科大鼎新电子科技有限公司。

本标准主要起草人:林良、向翠华、向磊、苗海川、臧晓丹、苗洪远、闫茹、李天祥、周晓光、刘洁。

半导体封装用键合银丝

1 范围

本标准规定了半导体分立器件、集成电路、LED封装用键合银丝(以下简称银丝)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存质量证明书、订货单(或合同)等内容。

本标准适用于半导体封装用键合银丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1423 贵金属及其合金密度的测试方法

GB/T 8750—2014 半导体封装用键合金丝

GB/T 10573 有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T 11067(所有部分) 银化学分析方法

GB/T 15072(所有部分) 贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 种类、型号、牌号、状态和规格

银丝按化学成分分为普通银丝、合金银丝两大类。普通银丝是Ag含量99%及以上的银丝CS,合金银丝可以根据合金元素及其含量不同分为AS1、AS2、AS3和AS4等4个型号。银丝的种类、型号、状态和直径应符合表1的规定。

表1 种类、型号、牌号和直径

种类	型号	牌号	状态	直径/mm
普通银丝	CS	Ag99	半硬态	0.018、0.020、0.023、0.025、0.028、0.030、 0.032、0.033、0.035、0.038、0.040、0.045、0.050
合金银丝	AS1	Ag88AuPd		
	AS2	Ag92AuPd		
	AS3	Ag95PdAu		
	AS4	Ag97PdAu		
注:根据需方的要求可增加其他直径的银丝。				

3.1.2 标记示例

每轴银丝标记按产品名称、标准编号、牌号、状态及尺寸规格的顺序表示。标记示例如下: